



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15138—94

---

## 膜集成电路和混合集成电路外形尺寸

Case outlines for film integrated circuits  
and hybrid integrated circuits

1994-12-25 发布

1995-04-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 目 次

1 主题内容与适用范围 .....	( 1 )
2 引用标准 .....	( 1 )
3 封装形式及代号 .....	( 1 )
3.1 封装形式 .....	( 1 )
3.2 外形代号的编号方法 .....	( 2 )
4 引出端的识别及编号 .....	( 2 )
5 尺寸的文字符号 .....	( 2 )
6 尺寸和公差 .....	( 2 )
7 外形图 .....	( 2 )
7.1 金属双列封装(M型) .....	( 2 )
7.2 金属四周封装(Ms型) .....	( 9 )
7.3 金属扁平封装(Mb型) .....	( 12 )
7.4 金属圆形封装(T型) .....	( 14 )
7.5 金属圆形四周封装(Ts型) .....	( 14 )
7.6 陶瓷双列封装(D型) .....	( 15 )
7.7 陶瓷熔封双列封装(J型) .....	( 20 )
7.8 陶瓷扁平封装(F型) .....	( 22 )
7.9 陶瓷针栅阵列封装(G型) .....	( 22 )
7.10 塑料双列封装(P型) .....	( 22 )
7.11 塑料双列弯引线封装(O型) .....	( 22 )
7.12 塑料四面引线扁平封装(N型) .....	( 22 )
7.13 其他封装 .....	( 22 )
附录 A 外形代号的编号方法(补充件) .....	( 27 )
附录 B 尺寸符号的含义(补充件) .....	( 29 )

# 中华人民共和国国家标准

## 膜集成电路和混合集成电路外形尺寸

GB/T 15138—94

Case outlines for film integrated circuits  
and hybrid integrated circuits

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了膜集成电路和混合集成电路的封装形式及外形尺寸,适用于膜集成电路和混合集成电路成品尺寸检验和封装设计。

### 2 引用标准

- GB 1182 形状和位置公差 代号及其注法
- GB 1183 形状和位置公差 术语及定义
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB 4457.4 机械制图 图线
- GB 4458.1 机械制图 图样画法
- GB 4458.4 机械制图 尺寸注法
- GB 7092 半导体集成电路外形尺寸
- IEC 191 半导体器件机械标准化

### 3 封装形式及代号

#### 3.1 封装形式

##### 3.1.1 金属封装

- a. M型 金属双列封装
- b. Ms型 金属四周封装
- c. Mb型 金属扁平封装
- d. T型 金属圆形封装
- e. Ts型 金属圆形四周封装

##### 3.1.2 陶瓷封装

- a. D型 陶瓷双列封装
- b. J型 陶瓷熔封双列封装
- c. F型 陶瓷扁平封装
- d. G型 陶瓷针栅阵列封装

##### 3.1.3 塑料封装

- a. P型 塑料双列封装
- b. O型 塑料双列弯引线封装
- c. N型 塑料四面引线扁平封装

##### 3.1.4 其他封装

国家技术监督局1994-06-25批准

1995-04-01实施